

2022年7月29日

各 位

会 社 名 新光電気工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 倉 嶋 進
コード番号 6967 東証プライム市場
問 合 せ 先 経営企画室長 清 野 貴 博
Tel (026) 283-1000 (代)

半導体メモリ向けプラスチックBGA基板の生産能力増強について

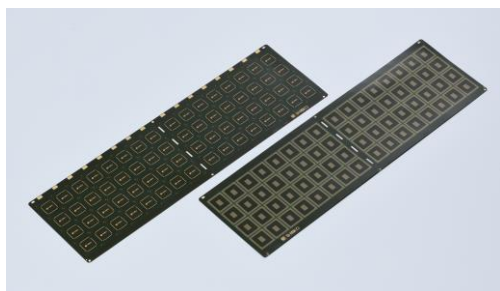
社会・経済のデジタル化の進展とともに、今後、半導体は幅広い分野において用途を広げ、市場はさらに拡大することが想定されます。当社は、高性能半導体向けフリップチップタイプパッケージ、半導体製造装置用セラミック静電チャックをはじめ、高い成長が見込まれる市場分野向けに重点的に経営資源を投下してまいりましたが、今般、半導体メモリーの小型・薄型化に対応するプラスチックBGA基板の増産をはかるため、設備投資を実施することといたしましたのでお知らせいたします。

当社のプラスチックBGA基板は、スマートフォン・自動車向けの半導体メモリーや、自動車向けのECU (Electronic Control Unit) を搭載する半導体パッケージとして数多く使用されています。今後、AI、IoTの活用の進展、5Gの普及等による飛躍的なデータ通信量の増加や、インフォテインメントシステムをはじめとする自動車のさらなる電装化等を背景として、半導体メモリーは高速・大容量化がさらに進み、需要拡大が見込まれるとともに、一層の微細・薄型・低電力のニーズが高まることが想定されます。当社は、これらに対応することを目的として、微細化・薄型化の先行技術MSAP工法によるプラスチックBGA基板の生産能力増強をはかるべく、当社新井工場（新潟県妙高市）内に新棟を建設することといたしました。

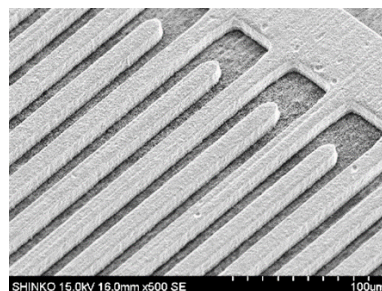
【設備投資の概要（予定）】

- (1)対象製品 : 半導体メモリ向けプラスチックBGA基板
- (2)投資額 : 280億円
- (3)生産能力 : 本設備投資により半導体メモリ向けプラスチックBGA基板の生産能力は、既存棟において既に設備投資に着手している新ライン（2023年度稼働予定）による寄与分を含め、現行比約2倍程度に増強することを見込んでおります。
- (4)新棟概要 :
 - ①所在地 新井工場内（新潟県妙高市）
 - ②建物構造 鉄骨造り 3階建て（一部4階）
 - ③延床面積 14千㎡
 - ④スケジュール 2024年度 着工
2025年度 竣工
2026年度 稼働開始

なお、新棟におきましては使用する電力を100%再生可能エネルギーでまかなう計画です。



プラスチックBGA基板



最先端技術による微細配線
(走査電子顕微鏡写真)

[プラスチックBGA基板について]

当社のプラスチックBGA基板は、小型・薄型化のニーズに対応する半導体パッケージとして、スマートフォンや自動車に搭載される半導体メモリーや、高い信頼性が求められる自動車向けのECUに主に使用されています。当社におきましては、エッチングによる配線形成に代えて、より微細な配線をめっきによって形成する先行技術MSAP (Modified Semi Additive Process) 工法の進化をはかり、半導体パッケージの小型・薄型化、そして多層化・高密度化のニーズにお応えしています。

このたびの設備投資計画による2023年3月期連結業績に与える影響につきましては、軽微であります。

以 上